

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年3月19日(2015.3.19)

【公開番号】特開2012-186446(P2012-186446A)

【公開日】平成24年9月27日(2012.9.27)

【年通号数】公開・登録公報2012-039

【出願番号】特願2012-142(P2012-142)

【国際特許分類】

H 01 L 21/301 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/78 W

【手続補正書】

【提出日】平成27年1月29日(2015.1.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

ダイシングテープに貼着されて、リング状のフレームにマウントされ、予め形成された分断予定ラインに沿って個々のチップにダイシング加工された半導体ウェハからなるワークを固定するフレーム固定手段と、

前記ワークのダイシングテープをエキスパンドするエキスバンド手段と、

前記ダイシングテープのエキスバンド状態を解除した後、前記ダイシングテープに発生する弛み部分を加熱するために、分割対象である半導体ウェハ外周のダイシングテープに熱を供給するように配置され、それぞれ加熱状態を周方向に独立して制御することが可能な光加熱装置と、

を備えたことを特徴とするワーク分割装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

前記目的を達成するために、本発明のワーク分割装置は、ダイシングテープに貼着されて、リング状のフレームにマウントされ、予め形成された分断予定ラインに沿って個々のチップにダイシング加工された半導体ウェハからなるワークを固定するフレーム固定手段と、前記ワークのダイシングテープをエキスパンドするエキスバンド手段と、前記ダイシングテープのエキスバンド状態を解除した後、前記ダイシングテープに発生する弛み部分を加熱するために、分割対象である半導体ウェハ外周のダイシングテープに熱を供給するように配置され、それぞれ加熱状態を周方向に独立して制御することが可能な光加熱装置と、を備えたことを特徴とする。